美格智能 投资者关系活动记录表

证券代码: 002881

证券简称: 美格智能

美格智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号: 2021-005

投资者关系活动类别	☑特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会
	□新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议
参与单位名称及人员姓名	1、中信证券 黄亚元 何尧 景林资产 谢涵韬 安信资管 林芸 安和资本 王珏
	高益基金 余维念 韶夏资本 叶柱良 尚道投资 王志飞
	2、天风证券 王奕红 袁昊 长城基金 余欢 平安基金 李鑫
	富荣基金 毛运宏 鹏华基金 周书臣
	天榕基金 赵世刚 周济资产 朱寿高 开宝资产 王平
	天风资管 殷成钢 东方嘉富 周辉
	3、光大证券 刘凯 石崎良 林仕霄
时间	2021年12月7日上午10点到11点,下午4点到5点;2021年12月8号上午
	10 点到 11 点
地点	深圳市福田区公司会议室; 天风证券策略会现场
上市公司接待人员姓名	董事会秘书黄敏
	一、董事会秘书对公司情况及三季度经营情况进行简要介绍
	二、交流环节:
	1、公司业务类型与其他模组厂商有哪些不同?智能模组有哪些特性?标准数传
	模组发展情况如何?
投资者关系活动主要内容	答:公司坚持模组+解决方案的产品策略,根据下游客户需求不同,提供模组(智
介绍	能算力模组/数据传输模组), PCBA 解决方案产品,终端产品,技术开发服务等。
	智能化、定制化的产品策略可以提升产品利润空间,并加强客户粘性。公司智能
	模组及解决方案产品在新零售、物流扫码、智能网联车等垂直行业的定制化应用
	开发领域有深厚的技术积累,已经形成了较强的研发技术壁垒。
	传统的数据传输模组主要解决蜂窝通信连接的问题,智能模组主要有三个特性:
	 蜂窝通信连接+定制化安卓操作系统+算力,让终端设备在接入网络的同时,具备

美格智能 投资者关系活动记录表

任务处理能力和计算能力,实现智能化的联网。公司认为智能模组在模组整体市场渗透率会不断上升,也大力向客户和行业推介智能模组,取得良好效果。

标准数传模组方面公司也建立了覆盖 NB、4G CAT1、4G LTE、5G、WiFi 等完整的产品序列,各项体系认证及运营商认证也极为丰富,客户数量不断增多,业务增速较快,发展势头良好。

2、包括新能源车在内的智能网联车市场发展迅速,公司在这块拓展情况如何? 答:公司智能网联车客户群体在不断扩大,这也是公司近年来重点投入的领域。 公司的标准数传模组已经大批量应用于TBOX等传统车载产品领域,公司的智能模 组产品在智能座舱、ADAS\DMS等辅助驾驶领域大批量应用。公司5G智能模组产品 已经向国内领先新能源车企量产出货,应用于智能座舱系统。

随着安卓操作系统向车载领域的不断渗透,以及智能座舱一芯多屏、多路摄像头接入等趋势不断发展,预计公司的智能模组产品会迎来广阔市场空间。

公司车载方面的客户涵盖了整车厂、TIER1厂家、后装客户等,公司在现有客户资源基础上,对新势力厂家,国产自主品牌、核心TIER1等都加强了市场开拓力度,客户资源不断丰富。

3、应用于智能座舱的智能模组方案与传统的车规级方案有哪些不同,优势在哪 里?

答:公司应用于智能座舱领域的智能模组产品方案主要用于 4G/5G 网络接入和车载中控屏幕及摄像头的驱动和控制。应用智能模组方案的车辆,不需要再采用 TB0X 方案来接入网络。智能模组方案采用可插拔模块化设计,可以快速匹配不同车型;产品迭代速度较车规级方案更快,满足车载硬件快速升级的需求;安卓系统软件适配性更强,并且易于用户操作,贴近市场需求。成本方面也有优势。

4、公司产品的主要下游应用领域有哪些?各个应用领域的发展情况如何?

答:公司产品的主要下游应用领域分为:1、以新零售、物流扫码为代表的物联网泛连接领域;2、FWA 领域;3、智能网联车领域。公司在这些应用领域都有完备的产品布局,叠加市场开拓进展顺利,今年以来这三大应用领域的增速都较快,FWA 和智能网联车领域的增速要快于泛连接领域。公司也将不断开拓诸如 PC、云计算、机器人、绿色能源等新的大颗粒应用市场。

5、FWA 市场是不是主要集中在海外,公司扩展情况如何?

美格智能 投资者关系活动记录表

	答:FWA 是指固定无线接入,适用于没有光纤而直接将 4G\5G 信号转化为 WIFI 信
	号的场景,主要产品形态有 CPE\IDU\ODU\MIFI 等,主要市场集中在海外。FWA 市
	场公司在海外和国内都有销售团队,已经向多家海外运营商直接大批量供货。公
	司在 FWA 产品研发方面有多年研发积累,熟悉 FWA 产品的技术特性及海外运营商
	技术应答及认证流程。目前 4G 和 5G 产品都有。主要客户为海外运营商及品牌客
	户。北美及日本市场在持续发货,欧洲销售和技术支持团队已经在今年年初落地,
	已经有项目及订单导入,且正在积极参与各大运营商 4G/5G FWA 产品项目应答和
	招标。
	6、公司合作的主芯片厂家主要有哪些?
	答:随着公司营业规模扩大,下游客户需求多样化,公司采用多芯片平台共同发
	展的策略,目前与高通、展锐、海思、移芯等均有合作,其中以高通和展锐方案
	为主。
附件清单(如有)	无
日期	2021年12月8日